

证券代码：603005

证券简称：晶方科技



# 苏州晶方半导体科技股份有限公司

## 非公开发行 A 股股票预案

二〇一九年十二月

## 发行人声明

公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

公司本次非公开发行股票预案（以下简称“本预案”）是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

## 特别提示

一、苏州晶方半导体科技股份有限公司本次非公开发行股票相关事项已于 2019 年 12 月 31 日经公司第四届董事会第三临时次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会的批准和中国证券监督管理委员会的核准。

二、本次非公开发行的股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的 20%，即不超过 45,935,891 股（含）。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本公司股票在董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项，本次非公开发行股票数量将进行相应调整。

三、本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合法投资者等合计不超过 10 名的特定对象。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个认购对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定及本预案所规定的条件，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

四、本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行的股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

最终发行价格将在公司取得中国证监会等证券监管部门关于本次非公开发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增

股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。

五、本次非公开发行股票募集资金总额不超过 140,226.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额全部用于集成电路 12 英寸 TSV 及异质集成智能传感器模块项目。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司通过自筹资金或者其他方式解决。

为满足项目开展的需要，本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

六、本次发行完成后，发行对象所认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。

七、公司股权结构较为分散，本次发行前后均无控股股东和实际控制人，本次发行不会导致公司无实际控制人的治理结构发生变化。

八、本次非公开发行完成后，不会导致公司股权分布不具备上市条件。

九、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法规的要求，公司章程对公司的利润分配政策进行了明确规定。关于公司利润分配政策、最近三年现金分红情况以及未来分红规划等详细情况，详见本预案“第五节 公司利润分配政策及执行情况”部分相关内容。

十、根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关法规的要求，公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析，相关情况及公司拟采取的措施详见本预案“第六节 本次发行摊薄即期回报及填补措施”。公司制订的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，提请广大投资者注意投资风险。

# 目 录

发行人声明.....	1
特别提示 .....	2
目 录.....	4
释 义.....	1
<b>第一节 本次非公开发行股票方案概要.....</b>	<b>3</b>
一、公司的基本情况.....	3
二、本次非公开发行的背景和目的.....	4
三、发行对象及其与公司的关系.....	5
四、发行股份的价格及定价原则、发行数量及限售期.....	5
五、募集资金投向.....	7
六、本次发行是否构成关联交易.....	7
七、本次发行是否导致公司控制权发生变化.....	7
八、本次发行前滚存未分配利润安排.....	7
九、本次发行取得批准的情况及尚需履行的批准程序.....	8
<b>第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.....</b>	<b>9</b>
一、本次募集资金的使用计划.....	9
二、本次募集资金投资项目情况.....	9
三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响.....	15
四、募集资金投资项目可行性分析结论.....	15
<b>第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.....</b>	<b>16</b>
一、本次发行对公司业务结构、公司章程、股东结构、高管人员结构的 影响情况.....	16
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.....	17
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易 及同业竞争等变化情况.....	17
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人 占用，或为控股股东及其关联人提供担保的情形.....	17
五、本次发行对公司负债结构的影响.....	17
<b>第四节 本次发行的相关风险 .....</b>	<b>19</b>
一、行业波动风险.....	19

二、产业政策变化风险.....	19
三、募集资金投资项目无法产生预期收益的风险.....	19
四、每股收益与净资产收益率摊薄的风险.....	20
五、业务规模扩大产生的管理风险.....	20
六、审批风险.....	20
七、股市波动的风险.....	20
<b>第五节 公司利润分配政策及执行情况.....</b>	<b>21</b>
一、公司利润分配政策.....	21
二、公司最近三年现金股利分配及未分配利润使用情况.....	23
三、公司未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划.....	23
<b>第六节 本次发行摊薄即期回报及填补措施.....</b>	<b>27</b>
一、本次发行的影响分析.....	27
二、对于本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示.....	30
三、董事会选择本次融资的必要性和合理性.....	30
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况.....	30
五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报、增强公司持续回报能力采取的措施.....	31
六、相关主体作出的的承诺.....	34
七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序.....	34

## 释 义

在本非公开发行股票预案中，除非另有说明，下列词语或简称具有如下特定含义：

发行人、公司、本公司、晶方科技	指	苏州晶方半导体科技股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本次发行、本次非公开发行	指	公司本次向不超过十名特定对象非公开发行 A 股股票的行为
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《苏州晶方半导体科技股份有限公司章程》
股东大会	指	公司股东大会
董事会	指	公司董事会
监事会	指	公司监事会
本预案	指	苏州晶方半导体科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案
定价基准日	指	本次非公开发行的发行期首日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中新创投	指	中新苏州工业园区创业投资有限公司，公司第一大股东
EIPAT	指	ENGINEERING AND IP ADVANCED TECHNOLOGIES LTD，公司第二大股东
大基金	指	国家集成电路产业投资基金股份有限公司，公司第三大股东
主要股东	指	本次发行前持有公司 5%以上股份的股东，即中新创投、EIPAT 和大基金
智瑞达	指	智瑞达科技（苏州）有限公司、智瑞达电子（苏州）有限公司
Sony	指	Sony Corporation，全球知名大型综合性跨国企业集团，专注于视听、电子游戏、通讯产品和信息技术等领域
OmniVision	指	OmniVision Technologies, Inc，豪威科技股份有限公司，全球最大的影像传感器供应商之一
GalaxyCore	指	格科微电子（香港）有限公司，全球一线图像传感器芯片设计公司
IHS	指	国际权威市场调研机构，专注于汽车、医疗、通信等领域
Yole Development	指	法国权威市场调研机构，专注于影像传感器、MEMS 等领域
IP	指	知识产权（Intellectual Property）
半导体	指	常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料

集成电路（IC）	指	通过半导体工艺将电阻、电容、晶体管等电子元件集成在一起的具有特定功能的电路。
传感器	指	是一种检测装置，能感受到被测量的信息，并将感受到的信息按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出
CIS	指	影像传感器，是组成数字摄像头的重要组成部分
封装	指	将通过测试的晶圆加工得到独立芯片的过程，保护电路片免受周围环境的影响（包括物理、化学），起着保护芯片、增强导热（散）性能实现电气和物理连接、功率分配、信号分配，以沟通芯片内部与外电路的作用
晶圆	指	多指单晶硅圆片，由普通沙粒提炼而成，是最常用的是半导体材料，按其直径分为 4 英寸、5 英寸、6 英寸、8 英寸、12 英寸等规格，目前以 8 英寸为主流
模块	指	在通信、计算机、数据处理控制系统的电路中，可组合和更换的硬件单元
MEMS	指	微机电系统（Micro-Electro-Mechanical System），以微电子、微机械及材料科学为基础，研究、设计、制造具有特定功能的微型装置，常见的有压力传感器、加速度计、微陀螺仪
DRAM	指	动态随机存取存储器（Dynamic Random Access Memory），一种常见的系统内存
传感器模组	指	将完成封装后的智能传感芯片与光学镜头、对焦马达及其他被动元件等在基板上进行组装，最终形成可以直接装配在汽车及智能制造装备中的传感器模组
SiP	指	系统级封装技术（System In a Package）
CSP	指	芯片级封装（Chip Scale Package）
WLP	指	晶圆级封装（Wafer Level Packaging）
TSV	指	硅通孔（Through Silicon Via）
Fan-Out	指	扇外型封装
ADAS	指	先进驾驶辅助系统（Advanced Driver Assistance System），是一种利用各类传感器达到辅助驾驶功能的系统
3D 传感	指	一种通过获取一系列视觉数据形成三维立体图像的传感技术

注：本预案中所引用数据，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，该等差异系由四舍五入造成。



## 第一节 本次非公开发行股票方案概要

### 一、公司的基本情况

中文名称：苏州晶方半导体科技股份有限公司

英文名称：China Wafer Level CSP Co. Ltd.

注册地址：苏州工业园区汀兰巷 29 号

办公地址：苏州工业园区汀兰巷 29 号

股票简称：晶方科技

股票代码：603005

股票上市地：上海证券交易所

注册资本：229,679,455.00 元

法定代表人：王蔚

董事会秘书：段佳国

统一社会信用代码：913200007746765307

邮政编码：215026

互联网网址：[www.wlcsp.com](http://www.wlcsp.com)

电子信箱：[info@wlcsp.com](mailto:info@wlcsp.com)

联系电话：0512-67730001

联系传真：0512-67730808

经营范围：研发、生产、制造、封装和测试集成电路产品，销售本公司所生产的产品并提供相关的服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务：公司专注于传感器领域的封装测试业务，拥有多样化的先进封装技术，同时具备 8 英寸、12 英寸晶圆级芯片尺寸封装技术规模量产封装能力，为全球晶圆级芯片尺寸封装服务的主要提供者与技术引领者。封装产品主要包括影像传感器芯片、生物身份识别芯片、微机电系统芯片（MEMS）、环境光感应芯片、医疗电子器件、射频芯片等，该等产品广泛应用在消费电子（手机、电脑、照相机、游戏机）、安防监控、身份识别、汽车电子、虚拟现实、智能卡、医学电子等诸多领域。

## 二、本次非公开发行的背景和目的

### （一）本次非公开发行的背景

#### 1、先进封装行业快速发展，属国家产业政策重点支持领域

随着消费电子、物联网技术、智能制造、自动驾驶和3D传感等技术的快速发展，其关键元件-半导体传感器产业市场空间持续扩大。传统的半导体制造和封装工艺已经无法满足日益复杂的产品集成要求，产品设计的移动化、微型化、高集成度要求推动半导体封装技术由单芯片、单功能、大尺寸向多芯片、高性能和高集成度方向发展。先进封装技术已成为国内、国际集成电路产业链企业重点布局的战略领域，国家先后出台一系列政策支持鼓励先进封装行业发展。2017年1月，工信部公布的《信息产业发展指南》强调大力推进系统级封装（SiP）发展，推动芯片级封装（CSP）、圆片级封装（WLP）、硅通孔（TSV）、三维封装产业化，提升和完善集成电路产业芯片、模块及系统级计量测试技术水平和产业化规模。

#### 2、本次募投项目应用领域出现了新的需求趋势

公司专注于传感器领域，目前封测的产品主要为影像传感器和生物身份识别传感器。本次募投项目主要应用于手机摄像、汽车电子、生物身份识别、安防监控等领域，随着物联网和人工智能趋势的不断推进，这些领域正呈现出强劲的增长趋势。手机是影像传感器的最大终端用户市场，未来手机摄像头的需求依然强劲，其成长动力主要来自三摄、四摄对摄像头数量的提升，每部手机摄像头数目将大幅度增加；汽车电子中自动驾驶需要多个摄像头传感器，未来增长爆发力足；全面屏+OLED 逐渐成为未来手机的主流解决方案，以及手机多摄像头和更大的电池占用手机背部空间，屏下指纹将成为手机指纹识别主流的市场趋势，指纹传感器需求扩容确定性大；安防监控的普及度增加，安防监控市场传感器将会迎来稳定增长。

### （二）本次非公开发行的目的

公司本次非公开发行符合国家的产业政策，顺应未来市场新产品需求趋势，有利于公司解决公司产能受限问题，提升公司市场规模，进一步巩固公司行业

领先地位并提升核心竞争力，为公司运营和业绩的持续快速增长奠定坚实的基础。具体内容详见本预案“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目情况”之“（二）本次募集资金使用的必要性”部分相关内容。

### **三、发行对象及其与公司的关系**

#### **（一）发行对象**

本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合法投资者等合计不超过10名的特定对象。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个认购对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定及本预案所规定的条件，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

#### **（二）发行对象与公司的关系**

截至本预案出具之日，公司本次发行尚无确定的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。发行对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的《发行情况报告书》等相关文件中披露。

### **四、发行股份的价格及定价原则、发行数量及限售期**

#### **（一）本次发行股票的种类和面值**

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

#### **（二）发行方式**

本次发行采用非公开发行方式，在中国证监会等证券监管部门核准的有效期限内选择适当时机向特定对象发行。

#### **（三）发行对象及认购方式**

本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者

者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合法投资者等合计不超过10名的特定对象。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个认购对象。信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

最终发行对象将由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后,按照中国证监会相关规定及本预案所规定的条件,根据询价结果与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

#### **(四) 发行价格及定价原则**

本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行的股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% (定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)。

本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会等证券监管部门关于本次发行的核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,由公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。

#### **(五) 发行数量**

本次非公开发行的股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的 20%,即不超过 45,935,891 股(含)。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及发行时的实际情况,与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若本公司股票在董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项,本次非公开发行股票数量将进行相应调整。

#### **(六) 限售期**

发行对象认购的本次非公开发行的股份,自该等股份发行结束之日起12个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的,依其规定。

#### **(七) 上市地点**

在限售期届满后,本次非公开发行的股票在上海证券交易所上市交易。

### （八）议案的有效期

本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。

## 五、募集资金投向

本次发行预计募集资金总额不超过140,226万元，扣除发行费用后募集资金净额拟全部用于以下项目的投资：

单位：万元

项目名称	项目投资总金额	拟使用募集资金投资金额
集成电路12英寸 TSV 及异质集成智能传感器模块项目	140,226.00	140,226.00

若本次非公开发行实际募集资金净额不能满足以上项目的资金需求，公司将利用自筹资金解决不足部分。为满足项目开展的需要，本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据以上项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序置换前期投入。

## 六、本次发行是否构成关联交易

本次发行尚未确定发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次非公开发行股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露。

## 七、本次发行是否导致公司控制权发生变化

截至本预案出具之日，持有公司5%以上股份股东的持股情况如下：中新创投直接持有公司55,048,276股股份，持股比例为23.97%，为公司第一大股东；EIPAT 直接持有公司26,909,637股股份，持股比例为11.72%，为公司第二大股东；大基金直接持有公司21,677,753股股份，持股比例为9.44%，为公司第三大股东。公司股权结构分散，持股5%以上股东无一致行动协议或约定，无单一股东能对股东大会、董事会以及日常经营具有绝对控制或影响力，公司无控股股东和实际控制人。

本次发行完成后，公司股权结构未发生重大变化，公司仍无控股股东及实际控制人。

## 八、本次发行前滚存未分配利润安排

本次非公开发行股票前的公司滚存未分配利润，由本次非公开发行股票完成

后的新老股东按持股比例共享。

上述未分配利润的安排尚待公司股东大会审议通过。

## **九、本次发行取得批准的情况及尚需履行的批准程序**

本次非公开发行预案已于2019年12月31日经公司第四届董事会第三次临时会议审议通过，本次发行尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会核准。

在获得中国证监会核准后，公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票登记、发行和上市事宜，完成本次非公开发行全部申报和批准程序。

## 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

### 一、本次募集资金的使用计划

本次非公开发行的股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的20%，即不超过45,935,891股（含），募集资金总额不超过140,226万元，扣除发行费用后募集资金净额拟全部用于以下项目的投资：

单位：万元

项目名称	项目投资总金额	拟使用募集资金投资金额
集成电路12英寸 TSV 及异质集成智能传感器模块项目	140,226.00	140,226.00

若本次非公开发行实际募集资金净额不能满足以上项目的资金需求，公司将利用自筹资金解决不足部分。为满足项目开展的需要，本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据以上项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序置换前期投入。

### 二、本次募集资金投资项目情况

本次发行募集资金总额扣除发行费用后将用于集成电路12英寸TSV及异质集成智能传感器模块项目。本次募集资金投资项目具体情况如下：

#### （一）项目概况

本次募集资金投资项目名称为“集成电路12英寸TSV及异质集成智能传感器模块项目”，主要建设内容围绕影像传感器和生物身份识别传感器两大产品领域。项目建成后将形成年产18万片的生产能力。

本项目实施单位为苏州晶方半导体科技股份有限公司，项目建设期1年。

#### （二）本次募集资金使用的必要性和可行性分析

##### 1、项目实施的必要性

##### （1）顺应市场新产品需求趋势，推动公司工艺与设备的升级换代

公司产品主要应用于影像传感器和生物身份识别传感器。由于手机三摄、四摄的趋势导致摄像头数量大幅增加，传感器在安防监控和汽车电子领域的应

用稳定增长、屏下指纹将成为手机生物身份识别主流等市场产品趋势，影像传感器和生物身份识别传感器的封测需求大幅增加，公司已经针对市场需求的新趋势进行了前瞻性的技术储备和布局，目前生产已达到饱和状态，现有产能已经无法满足市场的需求，公司有必要通过本项目一方面扩大产能，同时对工艺与及机器设备进行相应升级换代，顺应市场新产品趋势，满足客户的新产品需求。

## **(2) 进一步扩大公司行业技术的领先地位**

公司自设立以来，坚持“做强”而非“做大”的公司战略，专注于传感器领域，通过持续不断的技术积累，保持在这一领域的技术领先地位，以满足客户提出的新产品需求，从而实现公司持续稳定的发展。

近几年，公司已对市场需求的新趋势进行了前瞻性的技术储备和布局。针对汽车电子等领域高可靠性的要求，公司在 12 寸消费类传感器用 TSV 晶圆级封装工艺的基础上，开发出了高可靠性 TSV 晶圆级封装工艺；针对市场高可靠性、高集成度、多芯片的市场需求趋势，公司 2014 年收购 DRAM 专业封测厂智瑞达电子（原德资奇梦达苏州封测厂），全面导入传统封装量产能力，将其与公司原有的先进封装技术互补，融合并再创新，率先推出了具有国际领先水平和具备完整 IP 的高端智能传感器用扇外型系统级封装平台。

本次投资项目将推动高可靠性 TSV 晶圆级封装工艺、扇外型系统级封装工艺平台等技术的发展，进一步巩固公司已有的技术领先优势和地位。

## **2、项目实施的可行性**

### **(1) 长期稳定的战略客户资源**

公司目前核心客户是全球传感器主流设计企业，也是国际知名半导体企业，这些公司目前占据着传感器产品领域大部分市场份额，主导着全球传感器产品技术发展趋势。

公司凭借自身技术优势，彼此之间已在 8 英寸和 12 英寸的 3D、TSV 封装领域开展了多年的研发和业务合作，成长为这些国际知名半导体企业长期的战略合作伙伴与稳定供应商，成为全球晶圆级芯片尺寸封装服务的主要提供者与技术引领



者，是这些核心客户目前不可或缺的合作伙伴，未来将与这些核心客户一起分享传感器市场的良好发展前景。

## **(2) 坚实的技术基础**

公司为世界上最早涉足传感器晶圆级封装量产业务的公司之一，是国内传感器晶圆级封装技术的引入者，全球12英寸晶圆级芯片尺寸封装技术的开发者，也是国内首家量产生物身份识别芯片晶圆级封装技术的实践者，经过十余年的技术积累和自主研发，在传感器先进封装领域拥有显著的技术领先优势以及成熟的技术商业化应用经验，这都将为本次募集资金投资项目的实施提供了可靠的技术支持。

### **1) 丰富的技术积累及完整的专利布局**

在 2005 年成功引进、吸收、消化以色列晶圆级封装技术后，公司顺应市场需求不断研发创新并引领行业技术发展，成为国内首家拥有超薄晶圆级芯片尺寸封装技术（Thin package 技术）、12 英寸传感器用硅通孔晶圆级封装等先进封装技术的企业。另外，公司 2014 年通过收购 DRAM 专业封测厂智瑞达电子，拥有了 LGA、BGA、模组等多样化的封装技术和模组制造能力，并将其与公司原有的先进封装技术融合，率先推出了具有国际领先水平扇外型系统级（Fan-out SiP）封装技术。公司先后承担 20 多项国家及省级科研项目，其中包括三个国家科技重大专项—02 专项。

公司一直以来重视新技术的自主研发和专利保护，经过长期自主创新积累，公司在技术创新和产品开发上取得了较多专利成果，在中国大陆、中国台湾、中国香港、美国、日本、韩国等地均有专利布局，已在传感器领域拥有全球封装量产企业中完整的专利布局，涵盖芯片设计、先进封装乃至模组工艺等诸多方面。

### **2) 成熟的技术商业化应用经验**

在研发投入力度不断上升的知识经济时代，技术商业化能力跟技术研发能力同等重要。公司自2005年成立以来，不仅重视技术的自主研发能力，也非常重视技术的商业化应用能力，目前已经积累了丰富的技术商业化应用经验。

2005年，公司率先将以色列传感器类晶圆级先进封装技术引入国内，并顺利

于2006年成功量产。

2009年，公司基于多年技术积累，正式推出拥有自主知识产权的新一代超薄晶圆级芯片尺寸封装技术（Thin package技术），并将这一技术成功推向市场。

2013年，公司顺利建成全球第一条12英寸传感器用硅通孔晶圆级先进封装量产线，引领整个行业技术革新，进一步扩大全球领先优势。

2014年，公司成功实施了对智瑞达资产和业务的并购，智瑞达是一家在传统封装和测试领域有着多年技术和经验积累的半导体后道制造服务公司，从而使得公司在多芯片模组集成化封装方面积聚了大量的倒装、金球、晶圆重置等传统封装工艺方面的技术、人才、市场和产业链资源，具备封装-测试-模组的全方案服务能力，为公司的未来发展奠定新的业务基础与业务模式。

2017年，公司为顺应市场最新趋势，成功推出针对大尺寸、高性能要求传感器的扇外型先进封装技术，作为晶圆级先进封装技术的重要补充。

### （3）完备的场地和基础设施，以及扎实的人才队伍

经过多年经营与发展，公司在传感器先进封装领域已建立起完整的生产布局和扎实的人才队伍。发展至今，公司员工覆盖研发、生产、销售、管理各领域的专业人才。公司在美国硅谷设立了全资子公司，专门追踪和掌控最前沿的产业趋势和技术方向，以及国际一流客户的最新需求，以保证公司在影像传感器晶圆级封装领域的持续领先优势。公司拥有完善的场地和基础设施，新的投资将于公司现有厂区内实施。

### （三）项目发展前景

本次募投项目产品主要应用于手机摄像、汽车电子、生物身份识别、安防监控等领域，通过扩大产能顺应手机摄像、汽车电子、生物身份识别、安防监控等领域的新产品趋势，满足客户的新产品需求。

#### 1、手机影像传感器领域

手机领域是影像传感器最大的应用领域。未来手机摄像头的的需求依然强劲，其成长动力主要来自三摄、四摄对摄像头数量的提升。

搭载多摄成为行业新趋势。从传统的单摄到双摄，再到三摄、四摄等创新式开拓，单只手机摄像模组需求量增加。据Yole的统计显示，2018年平均每部智能手机CMOS图像传感器数量在2.3颗左右，2024年将达到3.4个，年复合增长率达到6.2%。

多摄手机渗透率快速提升。据Yole数据显示，2018年全球多摄手机渗透率为29%，预计未来多摄手机将成为市场主流，渗透率进一步提升。预计到2022年多摄手机渗透率将达到65%。

## 2、汽车电子影像传感器领域

随着电子信息技术的深入应用，汽车的电子化、智能化程度不断提升，智能汽车已成为全球各国重点布局的战略市场，智能化驾驶将成为未来汽车电子领域的主要发展方向。影像传感器是汽车智能化的必备元件，是汽车的眼睛，为汽车接收外界信息主要途径。

智能汽车如果需要通过实现自动紧急刹车(AEB)、自适应巡航(ACC)、疲劳监测、车道偏离辅助、360度环视等功能，需要配备很多个摄像头。汽车的大部分摄像头是为了实现摄像功能，主要对安全性和可靠性要求高，对像素要求并不高。这一特点与公司目前封装的安防监控领域摄像头相似，公司目前在安防监控封装领域已经成为龙头企业，这一基础强化了晶方科技进入汽车电子传感器封装领域的竞争优势。

根据IHS统计，2016年全球汽车电子的市场规模为1,160亿美元，预计2022年将达到1,602亿美元，年均复合增速为5.51%。其中，高级驾驶辅助系统(ADAS)增速最高，2016年市场规模为70.88亿美元，2022年预计将达214.47亿美元，复合增速达20.27%。

根据Yole Development预测，汽车传感器市场未来将以影像传感器、雷达、超声波三大传感器为主，整体市场规模在2022年将达到230亿美元，其中影像传感器的市场容量将达到77亿美元。

## 3、生物身份识别芯片领域

生物身份识别芯片是传感器的另一个重要细分领域。据HIS统计，2018年全球指纹识别芯片市场规模约17亿美元，出货量超过10亿颗，其中，光学屏下指纹芯片实现小批量应用。

在手机应用领域，手机多摄像头和更大的电池占用手机背部空间，全面屏智能手机屏下指纹设计将成为手机指纹识别主流。根据 Witsview 预测，2020 年全面屏智能手机出货量将达到 8 亿部，占比超过 50%，全面屏智能手机运用的光学屏下指纹识别芯片出货量将同步增长。

#### **4、安防监控影像传感器领域**

物联网普及为监控摄像机带来新增长点。物联网的出现使得监控摄像机不再局限于机场，火车站，银行和办公楼等企业应用。它们已经成为零售企业，智能城市和智能家居的重要组成部分，用于收集和分析大数据。

在过去10多年里，全球视频监控摄像头的数量经历了爆发式的增长，根据IHS的数据，2006年全球监控摄像头出货量不到1,000万部，到2013年已经超过1亿部，预计2019年可以达到1.8亿部。另外，全球安防镜头的清晰度也在逐步提高，2011年1080P镜头占比为48%，到2018年1080P镜头占比达68%，夜视技术提升与成本下降带动了安防高清镜头的需求增长。

2015年国内安防市场规模4,860亿元，预计到2020年可以达到9,952亿元，年复合增长率约15%。在安防领域内，视频监控占比较高，2016年国内视频监控962亿元，预计到2019年可以达到1,320亿元。

#### **（四）项目投资概算**

本项目拟投资140,226.00万元，主要用于机器设备购置及安装、无尘室装修与建设等。

#### **（五）项目经济效益测算**

本项目实施达标达产后，预计新增年均利润总额1.6亿元，预计投资回收期（税后）约6.19年（含建设期），内部收益率（税后）为13.83%。

#### **（六）项目建设用地**

本项目建设地点位于苏州工业园区长阳街133号，将于公司现有厂区内实施。

#### **（七）项目主要设备**

本项目拟投资的主要设备用于产品生产、测试。设备主要包括压合机、光刻机、曝光机、对位机、蚀刻机、溅镀机、显影机、PECVD、激光切割机、激光打孔机、测试机、匀胶机、喷胶机等。

#### **（八）项目涉及的报批事项**

本项目备案和环评相关手续正在办理当中。

### **三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响**

#### **(一) 本次发行对公司经营管理的影响**

本次募集资金的运用符合国家相关的产业政策以及公司战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。项目完成后，能够为公司未来发展增加新的盈利增长点，提升技术研发实力，进一步加强公司的市场竞争力，巩固公司的行业地位。本次非公开发行募集资金的运用合理、可行，符合本公司及全体股东的利益。

#### **(二) 本次发行对公司财务状况的影响**

##### **1、对公司财务状况的影响**

本次发行完成后，公司的总资产和净资产将相应增加。随着募集资金使用效益的实现，公司总资产和净资产规模将进一步提升，抗风险能力进一步增强。

##### **2、对公司盈利能力的影响**

本次募集资金的运用，一方面能够满足业务发展的资金需求，通过合理调节、配置公司资金，提升公司的主营业务收入水平。

##### **3、对公司现金流量的影响**

本次非公开发行募集资金到位后，公司的筹资活动现金流入将相应增加。随着项目投资资金的陆续投入，公司未来投资活动现金流出将有所增加。未来募集资金投资项目建设完成后，公司经营活动产生的现金流量将得到提升，现金流量状况将得到进一步优化。

### **四、募集资金投资项目可行性分析结论**

综上所述，公司本次非公开发行符合国家的产业政策，顺应未来市场需求趋势，有利于公司解决公司产能受限问题，提升公司市场规模，进一步巩固公司行业领先地位并提升核心竞争力，为公司运营和业绩的持续快速增长奠定坚实的基础。本次募集资金计划投资项目符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益，具备必要性和可行性。

### 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

#### 一、本次发行对公司业务结构、公司章程、股东结构、高管人员结构的影响情况

##### （一）本次发行对公司业务结构及资产的影响

本次募集资金将用于公司主营业务的发展，项目建设完成后公司将形成集成电路12英寸TSV及异质集成智能传感器模块年产18万片的生产能力。有助于公司实现公司盈利能力和核心竞争力的全面提升，保证公司的可持续发展。本次发行后，公司仍主要从事传感器领域的封装测试业务，公司主营业务不会发生重大变化。

本次非公开发行完成后，公司总资产、净资产将有一定幅度提升。

##### （二）本次发行对公司章程的影响

本次发行后，公司注册资本、股本结构将相应变化。公司将依据有关规定，根据发行情况对公司章程中有关公司注册资本、股本结构及相关条款进行相应修改。除此之外，暂无其他调整计划。

##### （三）本次发行对股东结构的影响

截至本预案出具之日，持有公司5%以上股份股东的持股情况如下：中新创投直接持有公司55,048,276股股份，持股比例为23.97%，为公司第一大股东；EIPAT 直接持有公司26,909,637股股份，持股比例为11.72%，为公司第二大股东；大基金直接持有公司21,677,753股股份，持股比例为9.44%，为公司第三大股东。公司股权结构分散，持股5%以上股东无一致行动协议或约定，无单一股东能对股东大会、董事会以及日常经营具有绝对控制或影响力，公司无控股股东和实际控制人。

本次发行完成后，公司股权结构未发生重大变化，公司仍无控股股东及实际控制人。

##### （四）本次发行对高管人员结构的影响

截至本预案出具之日，公司尚无对高级管理人员结构进行进一步调整的计划，本次发行不会对高级管理人员结构造成重大影响。如未来拟调整高管人员结构，公司将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

## 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

### （一）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的总资产和净资产将相应增加。随着募集资金使用效益的实现，公司总资产和净资产规模将进一步提升，抗风险能力进一步增强。

### （二）本次发行对公司盈利能力的影响

本次募集资金的运用，一方面能够满足业务发展的资金需求，通过合理调节、配置公司资金，提升公司的主营业务收入水平。

### （三）本次发行对公司现金流量的影响

本次非公开发行募集资金到位后，公司的筹资活动现金流入将相应增加。随着项目投资资金的陆续投入，公司未来投资活动现金流出将有所增加。未来募集资金投资项目建设完成后，公司经营活动产生的现金流量将得到提升，现金流量状况将得到进一步优化。

## 三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次发行完成后，公司仍无控股股东及实际控制人，公司与主要股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等方面不会发生重大变化。

## 四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用，或为控股股东及其关联人提供担保的情形

本次发行完成后，公司仍无控股股东及实际控制人，公司与主要股东及其关联人所发生的资金往来均属正常的业务往来，不会存在被违规占用资金、资产的情形，亦不会存在公司为主要股东及其关联人提供违规担保的情形。

## 五、本次发行对公司负债结构的影响

本次非公开发行募集资金到位、募集资金投资项目顺利开展和实施后，公司总资产与净资产规模将增加，资产负债率将下降；本次发行完成后，公司不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，也不存在财务结构

不合理的情况。



## 第四节 本次发行的相关风险

### 一、行业波动风险

公司长期专注于传感器领域的封装测试业务，位于集成电路生产与应用的中间环节，与集成电路生产及应用环节紧密相连，属于半导体集成电路（IC）产业中的集成电路封装测试行业。如果未来集成电路应用行业或集成电路设计与制造行业的发展出现较大波动，将对集成电路封装测试行业产生重大不利影响，因此公司所处行业受半导体行业的景气状况影响较大，全球半导体行业具有技术呈周期性发展、市场呈周期性波动的特点。2002 年至 2004 年，全球半导体行业处于高速增长阶段，2005 年至 2007 年增速比较缓慢，2008 年和 2009 年受金融危机的影响出现负增长，2010 年触底反弹并实现强劲复苏，2011 年至 2012 年受欧债危机影响，行业处于低位徘徊。2013 年以后，全球半导体行业处于缓慢复苏阶段，2015 年和 2016 年又呈现周期性调整特征，2017 年半导体行业增速较大，2018 年半导体产业创出新高，在 2019 年或后续可能迎来阶段性调整。行业与市场的周期性波动，可能对本公司整体经营业绩造成不利影响。

### 二、产业政策变化风险

公司所处集成电路产业是电子信息产业的基础，是衡量国家现代化程度和国际竞争力的重要标志。我国高度重视并大力支持集成电路产业的发展，先后出台了《国家集成电路产业发展推进纲要》、《信息产业发展指南》、《智能传感器产业三年行动指南（2017-2019 年）》等产业扶持政策，并成立了国家集成电路产业投资基金专项支持产业整体发展。如果未来我国产业政策、进出口政策、财政税收及投融资等一系列优惠政策发生重大不利变化，公司的经营将可能受到较大影响，经营业绩将可能大幅下滑。

### 三、募集资金投资项目无法产生预期收益的风险

本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后将全部用于集成电路 12 英寸 TSV 及异质集成智能传感器模块项目。本次募集资金投资项目是公司在对最新市场和行业技术趋势，以及公司自身发展战略和条件做出审慎分析基础上，做出的投资决策，公司对本次募集资金投资项目进行了充分的可行性论证。如项目建成投入使用后，市场环境突变、行业竞争加剧、产业政策发生重

大变化，相关产业不能保持同步协调发展，将给募集资金投资项目的预期效益带来较大不利影响。

#### **四、每股收益与净资产收益率摊薄的风险**

本次非公开发行股票募集资金到位后，公司股本规模和净资产将相应增加。由于公司本次非公开发行募集资金投资项目有一定的建设期，项目的效益存在一定的不确定性且需要在投产后逐步体现，未来每股收益和净资产收益率可能短期内会有所下降；但是随着募集资金效益的逐步实现，这一状况将得到逐渐改善。特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄每股收益与净资产收益率的风险。

#### **五、业务规模扩大产生的管理风险**

本次发行完成后，公司资产及产能规模进一步扩张，对公司的业务管理能力提出了更高的要求。若公司生产管理、销售管理、技术管理、人事管理、质量控制、风险控制等能力不能适应资产、业务规模迅速扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，将可能会引发相应的管理风险。

#### **六、审批风险**

本次非公开发行股票尚需经公司股东大会审议通过，本方案存在无法获得公司股东大会表决通过的可能；本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准，能否取得相关的批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。本次非公开发行存在未能通过审批的风险。

#### **七、股市波动的风险**

本次非公开发行将对公司的生产经营和财务状况产生影响，公司基本面的变化将影响公司股票的价格；另外，宏观经济形势变化、行业景气度变化、国家重大经济政策调整、股票市场供求变化以及投资者心理变化等因素，都会影响股票市场的价格，给投资者带来风险。上述风险因素可能影响股票价格，使其背离公司价值，因此存在一定的股票投资风险。

## 第五节 公司利润分配政策及执行情况

### 一、公司利润分配政策

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的相关要求，为规范公司利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者合法权益，公司现行《公司章程》对于利润分配政策规定如下：

#### （一）公司利润分配政策的基本原则

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

#### （二）利润分配的方式

公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，优先采用现金分红的利润分配方式。

#### （三）分红的条件及比例

在满足下列条件时，可以进行分红：

1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

在满足上述分红条件下，每年分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。

#### （四）现金分红的比例和期间间隔

董事会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化的现金分红政策。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净

资产的20%，且绝对值达到5,000万元。

公司原则上在每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

#### **（五）股票股利分配的条件**

在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

#### **（六）决策程序和机制**

公司每年利润分配预案由公司董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟定，经独立董事对利润分配预案发表独立意见，并经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式，通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提交利润分配预案的，应当在定期报告中说明原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。

#### **（七）公司利润分配政策的变更**

公司应当根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见制定或调整分红回报规划及计划。但公司应保证现行及未来的分红回报规划及计划不得违反以下原则：即在公司当年盈利且满足现金分红条件的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当次分配利润的20%。

如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因；调

整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时应当采用网络投票等方式为公众股东提供参会表决条件。利润分配政策调整方案应经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化是指以下情形之一：

- 1、因国家法律、法规及行业政策发生重大变化，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；
- 2、因出现战争、自然灾害等不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；
- 3、因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化，公司连续三个会计年度经营活动产生的现金流量净额与净利润之比均低于20%；
- 4、中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

公司历年的利润分配方案均符合当时执行的《公司章程》之规定，公司严格执行了《公司章程》规定的利润分配政策及现金分红政策。

## 二、公司最近三年现金股利分配及未分配利润使用情况

### （一）最近三年现金股利分配情况

单位：万元

项 目	2018年度	2017年度	2016年度
现金分红金额（含税）	1,639.34	1,977.88	1,156.15
归属于母公司股东的净利润	7,112.48	9,569.17	5,275.33
现金分红/归属于母公司股东的净利润	23.05%	20.67%	21.92%
<b>最近三年累计现金分红金额占年均归属于母公司股东净利润的比例</b>	<b>65.22%</b>		

### （二）未分配利润使用情况

公司未分配利润主要用于补充公司营运资金，用于支持公司正常的生产经营活动。未来根据公司实际经营情况，按照《公司章程》规定，经股东大会决议批准后可进行现金分红。

## 三、公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证

监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等规定和《公司章程》，为明确公司对股东的合理投资回报，完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司董事会制订了《苏州晶方半导体科技股份有限公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划》(以下简称“规划”)，具体内容如下：

### **(一) 分红回报规划的制定原则**

在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司充分考虑对投资者的合理投资回报，在兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展的同时，实施持续、稳定的利润分配政策，合理制定公司股东分红回报规划。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

### **(二) 公司制定本规划考虑的因素**

公司着眼于长远和可持续发展，以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护，并给予投资者稳定回报。在综合考虑了企业经营发展的实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，特别是在充分考虑和听取中小股东的要求和意愿的基础上，对股利分配作出制度性安排，细化分红回报规划，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持股利分配政策的连续性和稳定性。

制定本分红回报规划考虑的因素具体包括：公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资环境等情况。

### **(三) 公司未来三年(2019-2021年)的具体股东分红回报规划**

#### **1、利润分配的方式**

公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，优先采用现金分红的利润分配方式。

#### **2、现金分红的条件及比例**

公司实施现金分红的条件：

(1) 公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金后有可分配

利润，且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项（募集资金投资项目除外）；

（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（3）公司现金流能满足公司正常经营和长期发展的需要的。

（4）满足上述条件后，公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 20%；

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 20%，且绝对值达到 5,000 万元。

### 3、差异化现金分红政策

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

### 4、股票股利分配的条件

在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

### 5、利润分配的期间间隔

公司原则上在每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

### 6、利润分配的决策程序和机制

公司每年利润分配预案由公司董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟定，经独立董事对利润分配预案发表独立意见，并经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式，通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提交利润分配预案的，应当在定期报告中说明原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。

#### **（四）分红回报规划制定周期**

公司应当根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见制定或调整分红回报规划及计划。公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，对公司股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东分红回报计划，并由公司董事会结合公司具体经营状况，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定年度或中期分红方案。

#### **（五）上述规划的实施**

上述规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。



## 第六节 本次发行摊薄即期回报及填补措施

公司于 2019 年 12 月 31 日召开第四届董事会第三次临时会议,审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案,本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会核准。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17 号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)等相关规定,为保障中小投资者利益,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真的分析,现将本次非公开发行股票完成后对即期回报摊薄的影响及公司拟采取的措施说明如下:

### 一、本次发行的影响分析

本次发行完成后,公司的净资产规模将有所上升。短期内,在募集资金的效用尚不能完全得到发挥的情况下,公司的净资产收益率可能会受到一定影响,即期回报可能被摊薄。但从中长期看,公司非公开发行募集资金带来的资本金规模的增长将带动公司业务规模的扩张,并进而提升公司的盈利能力和净利润水平。公司将积极采取各种措施提高净资产和资本金的使用效率,以获得良好的净资产收益率。

#### (一) 主要假设

1、假设公司于 2020 年 6 月末完成本次非公开发行(该完成时间仅为公司估计,最终以经中国证监会核准并实际发行完成时间为准);

2、假设本次非公开发行股票预计发行数量为 45,935,891 股,募集资金到账金额为 140,226.00 万元(不考虑发行费用),本次发行完成后,公司总股本将由 229,679,455 股增至 275,615,346 股;

3、假设宏观经济环境、公司所处行业情况及公司经营环境没有发生重大不利变化;

4、公司 2019 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润为 5,191.61 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 1,995.68 万元;假设公司

2019 年归属母公司所有者的净利润及归属母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为公司 2019 年 1-9 月已实现的相应指标乘以 4/3；假设 2020 年归属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益前/后的净利润分别按以下三种情况进行测算：（1）与 2019 年持平；（2）比 2019 年增长 20%；（3）比 2019 年降低 20%；

5、以下测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）及股权激励等的影响；

6、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响；

7、上述假设分析中关于本次发行前后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

## （二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，公司测算了本次非公开发行股票对公司的每股收益和净资产收益率等主要财务指标的影响，具体如下：

单位：万元

项 目	2019 年度	2020 年度	
		本次发行前	本次发行后
总股本（万股）	22,967.95	22,967.95	27,561.53
<b>假设公司 2020 年归属于母公司股东的净利润与 2019 年持平</b>			
归属于母公司股东的净利润	6,922.14	6,922.14	6,922.14
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,660.90	2,660.90	2,660.90
基本每股收益（元/股）	0.30	0.30	0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.11	0.12	0.09
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.30	0.23
扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/股）	0.11	0.12	0.09
加权平均净资产收益率	3.63%	3.51%	3.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.40%	1.35%	1.33%
<b>假设公司 2020 年归属于母公司股东的净利润较 2019 年增长 20%</b>			

单位：万元

项 目	2019 年度	2020 年度	
		本次发行前	本次发行后
归属于母公司股东的净利润	6,922.14	8,306.57	8,306.57
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,660.90	3,193.08	3,193.08
基本每股收益（元/股）	0.30	0.36	0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.11	0.14	0.12
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.36	0.30
扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/股）	0.11	0.14	0.12
加权平均净资产收益率	3.63%	4.20%	4.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.40%	1.61%	1.60%
<b>假设公司 2020 年归属于母公司股东的净利润较 2019 年降低 20%</b>			
归属于母公司股东的净利润	6,922.14	5,537.71	5,537.71
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,660.90	2,128.72	2,128.72
基本每股收益（元/股）	0.30	0.24	0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.11	0.09	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.24	0.20
扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/股）	0.11	0.09	0.08
加权平均净资产收益率	3.63%	2.82%	2.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.40%	1.08%	1.07%

注 1：上述财务指标的计算方法具体如下：

- (1) 本次发行前的基本每股收益=当期归属于母公司股东的净利润/发行前总股本；
- (2) 本次发行后基本每股收益=当期归属于母公司股东的净利润/（发行前总股本+本次新增发行股份数×发行月份次月至年末的月份数÷12）；
- (3) 本次发行前的加权平均净资产收益率=当期归属于母公司股东的净利润÷（期初归属于母公司股东权益+当期归属于母公司股东的净利润÷2-本期现金分红×分红月份次月至年末的月份数÷12）；
- (4) 本次发行后的加权平均净资产收益率=当期归属于母公司股东的净利润÷（期初归属于母公司股东权益+当期归属于母公司股东的净利润÷2-本期现金分红×分红月份次月至年末的月份数÷12+本次发行募集资金总额×发行月份次月至年末的月份数÷12）。

根据上述假设测算，与本次发行前相比，本次发行后公司基本每股收益、

稀释每股收益和加权平均净资产收益率均有一定程度的下降。

## **二、对于本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示**

本次非公开发行股票募集资金到位后,公司股本规模和净资产将相应增加。由于公司本次非公开发行募集资金投资项目有一定的建设期,项目的效益存在一定的不确定性且需要在投产后逐步体现,未来每股收益和净资产收益率可能短期内会有所下降;但是随着募集资金效益的逐步实现,这一状况将得到逐渐改善。特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄每股收益与净资产收益率的风险。

## **三、董事会选择本次融资的必要性和合理性**

公司本次非公开发行符合国家的产业政策,顺应未来市场需求趋势,有利于公司解决公司产能受限问题,提升公司市场规模,进一步巩固公司行业领先地位并提升核心竞争力,为公司运营和业绩的持续快速增长奠定坚实的基础。本次募集资金计划投资项目符合公司发展战略,符合公司及全体股东利益。

关于本次募集资金投资项目的必要性和合理性分析,详见本预案“第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目情况”之“(二)本次募集资金使用的必要性和可行性分析”之“1、项目实施的必要性分析”。

## **四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况**

### **(一) 本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系**

公司专注于传感器领域的封装测试业务,拥有多样化的先进封装技术,同时具备 8 英寸、12 英寸晶圆级芯片尺寸封装技术规模量产封装能力,为全球晶圆级芯片尺寸封装服务的主要提供者与技术引领者。公司本次募集资金投资项目用于建设集成电路 12 英寸 TSV 及异质集成智能传感器模块项目,顺应未来市场需求趋势,有利于公司解决公司产能受限问题,提升公司市场规模,进一步巩固公司行业领先地位并提升核心竞争力,为公司运营和业绩的持续快速增长奠定坚实的基础。

### **(二) 公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况**

公司本次募集资金投资项目实施具备人员、技术、市场等方面的基础，关于本次募集资金投资项目在上述方面的储备情况分析，详见本预案“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目情况”之“（二）本次募集资金使用的必要性和可行性分析”之“2、项目实施的可行性分析”。

## **五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报、增强公司持续回报能力采取的措施**

### **（一）公司现有业务板块运营状况、发展态势**

公司专注于传感器领域的封装测试业务，封装产品主要包括影像传感器芯片、生物身份识别芯片、微机电系统芯片（MEMS）、环境光感应芯片、医疗电子器件、射频芯片等，该等产品广泛应用在消费电子（手机、电脑、照相机、游戏机）、安防监控、身份识别、汽车电子、虚拟现实、智能卡、医学电子等诸多领域。2016年至2019年9月各期，公司分别实现营业收入51,239.04万元、62,877.96万元、56,623.37万元和34,132.22万元，实现归属于母公司股东的净利润5,275.33万元、9,569.17万元、7,112.48万元和5,191.61万元。

2015年至2016年全球半导体产业呈现周期性调整特征，2017年和2018年半导体行业增速较大，公司经营业绩企稳回升。从整体产业规模看，全球半导体产业仍处于增长的态势。

### **（二）公司面临的主要风险及改进措施**

#### **1、行业波动风险及改进措施**

集成电路行业具有技术和市场呈周期性波动的特点。2013年以来，全球半导体行业处于缓慢复苏，2015年和2016年因全球智能手机增速疲软又呈现周期性调整特征，2017年半导体行业增速较大，2018年半导体产业创出新高，在2019年或后续可能迎来阶段性调整。行业与市场的周期性波动，可能对本公司整体经营业绩造成不利影响。未来公司将持续开发适合不同应用领域的传感器封装技术，不断深入挖掘全球市场及客户需求，重点开拓汽车电子、智能制造、3D传感等应用领域的传感器封装市场，从而有效降低因产品应用领域过度集中产生的行业波动风险。

#### **2、技术产业化风险及改进措施**

为顺应市场发展需求，拓展技术和产品的应用领域，公司持续开发了多样化的封装技术。由于集成电路行业存在技术更新快、研发投入大的特点，创新技术的产业化需要产业链的共同配合，因而，公司技术和工艺的产业化存在一定的不确定性。

未来公司将继续加强与全球一线传感器设计公司的战略合作，持续开展新产品和新技术的研发；主动向产业链上下游延伸，进一步加强产业链资源整合能力；推动传统半导体制造工艺与光学、声学、生物学等科技领域的跨界合作，全面提升公司的跨界研发能力。

### **3、成本上升风险及改进措施**

随着公司资产规模不断扩大，市场变化及行业发展环境等多方面因素，可能会导致公司资产运营成本上升。公司所属封装测试行业，人力成本占营业成本比例较高，随着公司生产规模的不断扩大，用工需求持续增加，但国内整体劳动力资源供应与人力成本上升的发展趋势，会使公司面临劳动力成本上升风险，可能会对公司造成不利影响。

公司将持续推进公司内部管理模式的改革，进一步提升公司生产管理水平与运营效率；积极整合厂区资源，发挥生产资源的规模效应；继续推进人力资源整合与激励制度的完善，有效提升公司的人力资源水平，进一步发挥员工的自主积极性。

### **(三) 加强公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩的具体措施**

为保证本次募集资金有效使用、有效防范股东即期回报被摊薄的风险、提高公司未来的持续回报能力，本次非公开发行股票完成后，公司将实施如下措施填补即期回报：全面提升公司管理水平，完善员工激励机制；加快募投项目实施进度，培育新的盈利增长点；加强募集资金管理，提高募集资金使用效率；加大研发投入和技术创新；不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障；完善现金分红政策，强化投资者回报机制。

#### **1、全面提升公司管理水平，完善员工激励机制**

在本次发行募集资金投资项目投产前，公司将继续围绕现有业务及产品，进一步优化业务流程，持续加强市场开拓，通过现有业务规模的扩大促进公司

业绩上升，降低由于本次发行对投资者回报摊薄的风险；另外，公司将进一步完善员工薪酬和激励机制，引进市场优秀人才，充分挖掘员工的创造力和潜在动力，以进一步促进公司业务发展。

## **2、加快募投项目实施进度，培育新的盈利增长点**

本次募集资金投资项目是对公司现有业务的进一步拓展，符合国家产业政策导向和公司经营发展战略。本次发行募集资金到位后，公司将合理安排项目的投资建设，在募集资金到位前通过自有资金先行投入，加快对募集资金投资项目实施，培育新的盈利增长点，争取尽快投产并实现预期效益，尽量降低本次发行对股东即期回报摊薄的风险。

## **3、加强募集资金管理，提高募集资金使用效率**

公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定管理和使用本次募集配套资金，确保募集资金存放于董事会指定的募集资金专项账户中并建立募集资金三方监管制度，合理防范募集资金使用风险，进一步提高募集资金使用效率。

## **4、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障**

公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

## **5、完善现金分红政策，强化投资者回报机制**

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的要求，为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者合法权益，公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策尤其是现金分红有关内容，明确了保护中小投资者利益的相关内容。

为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司制定了《未来三年（2019—2021 年）股东分红回报规划》。公司将严格执行《公司章程》和《未来三年（2019—2021 年）股东分红回报规划》中明确的利润分配政策，在公司业务不断发展的过程中，强化中小投资者权益保障机制，给予投资者合理回报。

## 六、相关主体作出的承诺

为使公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺如下：

（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

（2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

（4）承诺在自身职责和权限范围内，促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（5）若公司未来推出股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（6）本人作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人接受按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的相关处罚或采取相关监管措施。本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

## 七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

公司董事会对本次融资摊薄即期回报事项的分析、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项已经公司第四届董事会第三次临时会议审议通过，并将提交公司股东大会表决。

（以下无正文）



苏州晶方半导体科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 31 日